



# 中華民國專利證書

發明第 I 898901 號

發明名稱：半導體製程用切割膠帶、其組成物、及其製造方法

專利權人：南亞塑膠工業股份有限公司

發明人：袁敬堯、曹俊哲、賴振和

專利權期間：自 2025 年 9 月 21 日至 2044 年 10 月 28 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

廖承威

中華民國



114

年

9

月

21

日

